LEADING

Company Report

와이엠티(251370)

2018년 5월 14일

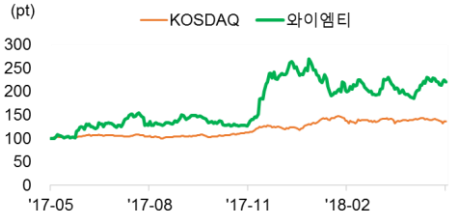
소재 국산화로 호황 이상의 호황

BUY(Initiate)

목표주가	47,000 원
현재주가	35,400 원
목표수익률	32.8 %
Key Data	**2018 년 5 월 11 일**
산업분류	제조
KOSDAQ (pt)	865.93
시가총액 (억원)	2,621
발행주식수 (백만주)	7
외국인 지분율 (%)	4.4
52 주 고가 (원)	43,400
저가 (원)	16,350
60 일 일평균거래대금 (십억원)	1.8
주요주주	(%)
전성욱 외 3인	45.3

주가상승률 (%)	1M	6M	12M
절대주가	10.8	56.0	103.7
상대주가	13.3	29.8	52.4

Relative Performance



LEADING RESEARCH

Analyst 서형석
hsseo@leading.co.kr
+822-2009-7086

Analyst 정태원
twchung@leading.co.kr
+822-2009-7087

투자의견 및 목표주가 : BUY & 47,000원

투자의견 '매수(BUY)' 및 목표주가 47,000 원을 제시하며, 커버리지를 개시. 목표주가 47,000 원은 12M Fwd BPS 12,354 원에 Target PBR 3.8 배를 적용. Target Valuation 은 동사의 과거 PBR Band 평균.

지난해 북미 세트 업체 向 RFPCB 물량이 국내로 이전함에 따라 국내 FPCB 시장 확대되었음. 올해 FPCB 시장은 스마트폰에 채택되는 Flexible OLED 디스플레이 확대, 듀얼 카메라 적용 스마트폰 증가 등 요인으로 인하여 호황이 유지될 것으로 예상. FPCB 시장 호황으로 동사의 동도금 用 화학소재 공급 및 자회사 YPT 社 의 기판가공 매출이 확대될 것으로 전망되어 실적 성장모멘텀을 확보하였다고 판단. 이에 동사의 과거 Valuation Band 평균을 적용.

실적전망 및 투자포인트

동사의 **'18 년 실적은 매출액 994 억원(YoY+43.7%), 영업이익 307 억원(YoY+91.0%), 당기순이익 237 억원 (YoY+163.4%) 을 전망**. 실적 성장은 전방 시장 성장에 따른 FPCB 시장 호황으로 동도금 화학소재 공급 증가와 기판 외주 가공 확대에 기인.

1) '18 년 동도금 매출액은 269 억원(YoY+84.1%) 추정. ① 국내 FPCB 시장 성장으로 동도금 화학소재의 공급 확대, ② 전기동도금 시장 진출 및 국산화 수요에 의한 점진적인 경쟁사 점유율 잠식, ③ 극동박 소재 판매 증대에 따른 매출 성장 예상.

2) 국내 PCB 업체들이 확보한 고부가가치 FPCB, RF-PCB 물량이 대폭 확대됨에 따른 기판가공 사업 호조 성장 전망.

3) 스마트폰 內 SLP 기판 확대로 Chemical 소재 공급 증가 기대.

Valuation Forecast

구분	단위	2015	2016	2017	2018F	2019F
매출액	억원	459	499	692	994	1,355
영업이익	억원	80	111	161	307	423
세전이익	억원	63	103	121	303	428
순이익	억원	47	77	90	237	336
지배순이익	억원	40	65	68	226	320
PER	배	-	-	43.90	11.91	8.41
PBR	배	-	-	5.12	3.33	2.38
EV/EBITDA	배	1.99	0.68	16.04	8.74	6.47

Source: Leading Research Center, K-IFRS 연결기준

투자포인트 1. FPCB 시장 성장으로 동도금 매출성장 지속

단면 또는 양면 제품 위주 시장에서 적층 구조의 다층 회로기판 시장으로 수요가 증가하며 동사와 같은 동도금 업체의 수혜가 확대되고 있다. 적층 구조의 회로기판이 의미가 있으려면 층과 층 사이 회로가 모두 연결되어 있어야 한다. 이를 연결하기 위해 필요한 공정이 바로 동도금 공정이다.

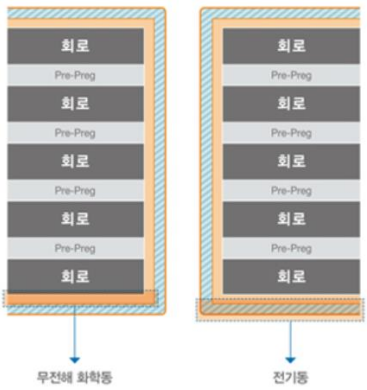
다층 회로기판은 회로 층과 플라스틱 소재 층이 반복되어 적층 구조가 완성된다. 플라스틱 단면에도 도금 층이 형성되려면 화학적 방식으로 도금 처리를 해야한다. 무전해 화학동도금과 전기적 방식의 도금이 차례대로 수행되어야 한다. 동사는 무전해 화학동도금 소재와 전기동도금 소재를 고객사에 모두 공급 중이다.

동사의 국내 동도금 시장점유율은 '16 년 30% 에서 '17 년말 기준 약 40% 수준까지 상승한 것으로 추정된다. 주요 경쟁사인 A 社 의 국내 시장점유율을 국내 고객사의 국산화 니즈에 따라 잠식하고 있는 추세이다.

주요 경쟁사인 A 社 는 도금 장비를 생산 및 판매하는 글로벌 기업이며 이들의 화학소재를 사용하지 않는 경우 장비의 유지보수 서비스를 제공하지 않고 있다. 고객사가 동사의 제품을 공급받아 사용하기 부담스러운 요인으로 작용하였다. 이에 동사는 동 경쟁사의 기술인력을 영입하였고, 동사의 자회사인 비욘드솔루션 社 와 합작하여 고객사에 기술서비스를 제공하고 있다. 이러한 대응으로 국내 점유율을 확대하고 있다.

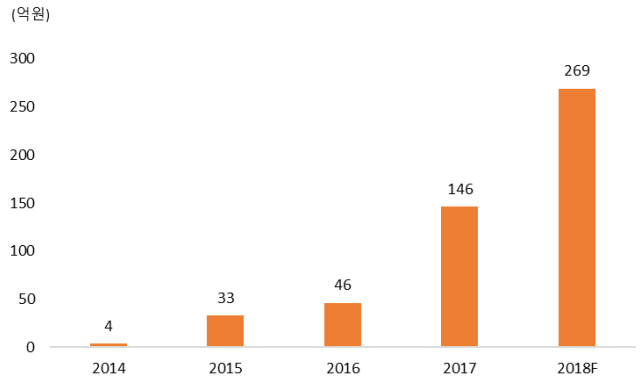
'18 년 동도금 매출액은 269 억원(YoY+84.1%)을 기록하며 높은 성장세를 지속할 것으로 분석된다. 첫째, 국내 FPCB 시장 성장으로 동도금 화학소재 공급 확대가 기대된다. 둘째, 전기동도금 시장 진출에 따라 경쟁사 점유율을 점진적으로 잠식할 것으로 예상된다. 셋째, 극동박 소재 판매에 따른 매출 성장이 전망된다.

Exhibit 1. 다층 PCB Hole 구조



Source: Company Data, Leading Research Center

Exhibit 2. 동도금 매출액 추이



Source: Company Data, Leading Research Center

첫째, 국내 FPCB 시장 성장에 따른 제품 공급확대가 기대된다. 주로 일본 PCB 업체들이 생산하던 북미 세트 업체 向 RFPCB 물량이 국내로 이전함에 따라 '17 년 국내 FPCB 시장의 확대가 이루어졌다. 글로벌 Flexible OLED 패널 출하 면적 증가, 스마트폰의 듀얼 및 트리플 카메라 채택, 3D 센싱 모듈 채택 등 요인으로 FPCB 사용량은 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

'18 년 북미 세트 업체의 스마트폰 OLED 채택은 2 개 모델로 예상된다. 그러나 '17 년 출시된 OLED 채택 스마트폰과 달리 RFPCB 와 멀티 기판을 각각 1 개씩 적용할 것으로 추정된다. 동사의 주요 고객사인 Z 社 가 동 멀티 기판 물량을 상당부분 확보할 가능성이 높다는 판단이다. 동사는 Z 社 內 높은 점유율을 유지하고 있어 수혜를 받을 것으로 기대된다.

둘째, 전기동도금 시장 진출에 따라 경쟁사 점유율을 점진적으로 잠식할 것으로 예상된다. 전기동도금은 PCB 위 동도금 공정을 수행한 후 생기는 gap 을 충진하는 공정이다. 제품가격이 높고 수익성이 좋아 ASP 상승에 기여하며 동사의 실적을 견인할 것으로 전망된다.

국내 시장은 일본의 E 社 와 독일의 A 社 가 과점하고 있다. 국내 고객사들은 전기동도금 화학소재를 100% 수입 제품에 의존하고 있어 국산화 니즈가 존재하는 것으로 분석된다. 기존 동도금 소재를 국산화하여 매출을 확대한 것과 같이 전기동도금 시장에서도 경쟁사의 점유율을 잠식하며 동사의 제품 공급을 확대할 것으로 예상된다.

셋째, 극동박 소재 판매에 따른 매출 성장이 전망된다. 신규 제품으로 2μm 극동박 소재를 개발하여 판매 중이다. 아직까지 실적은 미미하지만 '18 년 하반기부터 의미 있는 매출이 발생할 것으로 추정된다. 전기적 방식으로 동박을 형성하여 생산하고 있는 경쟁사와 달리 동사에 강점이 있는 동도금을 활용하여 소재를 생산하고 있다. 알루미늄 호일 위에 동도금 후 극동박을 생산하는 것이다.

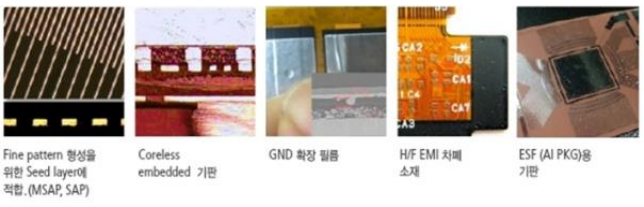
극동박 소재는 현재 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate, 연성동박적층판) 용으로 주로 사용된다. 현재 국내 시장은 일본 경쟁사가 독점하고 있는 상태이다. FCCL 시장은 아직까지 국산화 수요가 존재하지 않아 니치마켓(niche market)인 EMI Filter 소재 시장으로 진출하였다.

현재 EMI Filter 소재는 국내 경쟁사인 I 社 가 제조하는 6μm 이상 동박 소재를 주요 소재로 하여 생산 중이다. 동사의 극동박 소재는 2μm 수준이다. 스마트폰의 경박단소화 디자인 추세에 따라 EMI Filter 소형화 수요가 존재한다. EMI Filter 소재 시장으로 안정적인 진출 후 점진적으로 그 영역을 확대하여 후공정 기판 등 다양한 시장에서 성장동력을 확보할 것으로 기대된다.

Exhibit 3. 동사의 전기동도금 소재 특징

Source: Company Data, Leading Research Center

Exhibit 4. 극동박 소재 적용 가능 범위



Source: Company Data, Leading Research Center

투자포인트 2. 기판가공 사업 호조

'18 년 동사의 기판가공 부문 매출액은 263 억원(YoY+51.4%)으로 추정된다. 이는 전방 시장 성장에 따라 FPCB 사용량이 증가하며 PCB 업체들의 외주 가공이 확대됨에 기인한다. FPCB 시장 호황은 동사의 동도금 사업과 더불어 기판가공 사업의 실적 성장을 촉진시킬 전망이다. 동사의 자회사 YPT 社(지분율 84.81%) 를 통해 기판 외주가공을 수행하고 있다.

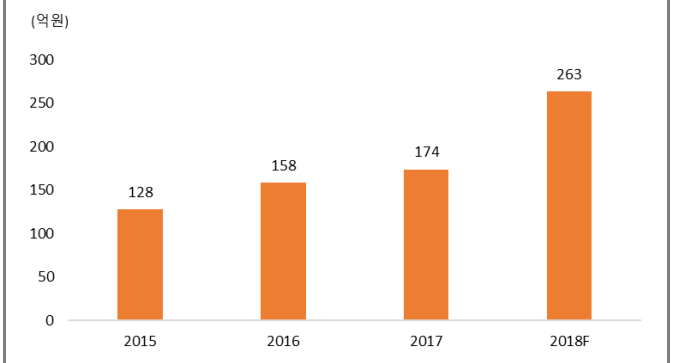
국내 PCB 업체들이 확보한 고부가가치 FPCB, RF-PCB 물량이 대폭 확대됨에 따라 생산능력이 수요를 따라가지 못하는 현상이 발생한다. 필수 공정 중 일부 공정의 설비를 PCB 업체가 자체적으로 도입하기 어렵거나 PCB 적층 공정의 기술적 난이도에 기인하여 병목현상이 발생하는 경우 수요량을 소화하지 못해 외주 가공 물량이 확대되고 있는 것으로 판단된다.

전방 시장 성장에 따른 글로벌 FPCB 시장 호황이 지속되며 동사의 외주 가공 매출은 지속적으로 확대될 것으로 분석된다. FPCB 시장은 스마트폰에 채택되는 Flexible OLED 디스플레이 확대, 듀얼 카메라 적용 스마트폰 증가 등 요인에 기인하여 호황이 유지될 것으로 전망되기 때문이다.

'17 년 기판가공 부문 매출액이 급증할 수 있었던 이유는 바로 듀얼 카메라이다. 듀얼 카메라가 적용된 스마트폰 모델 수가 증가함에 따라 필요한 FPCB 의 면적도 함께 증가하였다. 이에 따라 동도금 설비를 충분히 확보하지 못한 국내 PCB 업체들의 외주 가공 물량을 확보하였다.

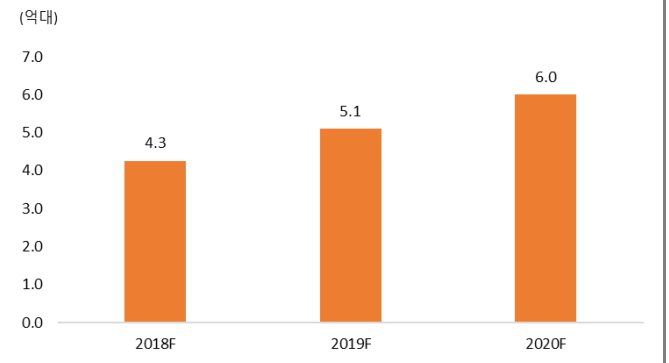
'18 년에도 이러한 추세는 지속될 전망이다. 국내 세트 업체의 중저가 모델 듀얼 카메라 적용 등이 주요 원인이다. 글로벌 듀얼 카메라 스마트폰은 '18 년 4 억 2,600 만대, '19 년 5 억 1,000 만대 규모로 추정된다. 중국 업체들의 듀얼 카메라 채택 모델 확대와 더불어 트리플 카메라 적용 또한 FPCB 수요를 견인할 요소로 판단된다.

Exhibit 5. 기판가공 매출액 추이



Source: Company Data, Leading Research Center

Exhibit 6. 글로벌 듀얼 카메라 스마트폰 대수 전망



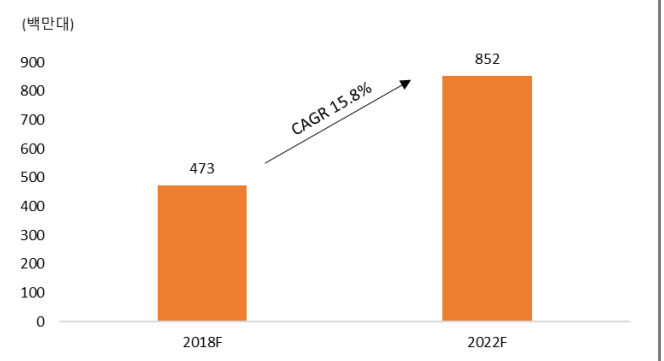
Source: 테크노시스템리서치, Leading Research Center

향후 FPCB 시장 호황은 OELD 디스플레이 시장이 견인할 전망이다. '18 년 스마트폰용 OLED 디스플레이 패널 출하량은 4.7 억대으로 전망된다. '22 년까지 연평균 16% 성장하여 8.5 억대 시장을 형성할 것으로 추정된다. OLED 디스플레이 패널 중 Flexible OLED 출하량 비중은 '18 년 47.6% 에서 '19 년 54.0% 로 상승하며 Rigid OLED 출하량을 넘어설 것으로 예상된다.

글로벌 OLED 시장 고성장세는 스마트폰 고사양화 및 프리미엄화 추세에 따른 글로벌 세트 업체들의 OLED 디스플레이 패널 채용 확대에 기인한다. 특히 동일한 크기의 스마트폰에 대형 화면 구현이 가능하게 하는 Full Screen 을 위한 Flexible OLED 채택이 수요를 견인할 전망이다.

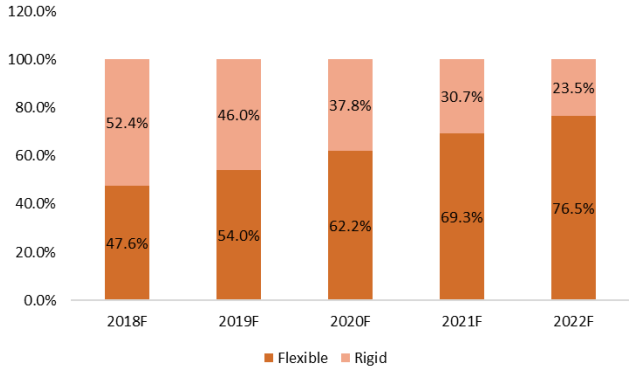
현재 국내 S 社 만 모바일용 Flexible OLED 양산 능력을 보유하고 있다. 국내 L 社, 중국의 B 社 와 C 社 등 글로벌 디스플레이 업체들까지 가세해 양산 능력 확보를 위한 대규모 투자를 집행하고 있다. Flexible OLED 시장 성장기에 진입함에 따라 FPCB 시장은 전방 시장과 동반 성장할 것으로 기대된다.

Exhibit 7. OLED 스마트폰 출하량 전망



Source: UBI Research, Leading Research Center

Exhibit 8. Flexible, Rigid OLED 비중 전망



Source: UBI Research, Leading Research Center

투자포인트 3. MSAP 공정 소재로 성장동력 확보

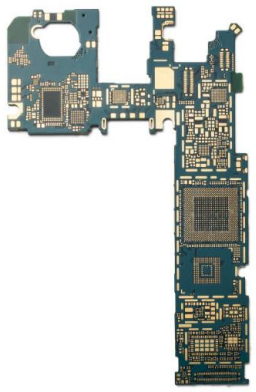
스마트폰 內 SLP(Substrate Like PCB) 기판 확대됨에 따른 동사의 Chemical 소재 공급 증가가 예상된다. 글로벌 세트 업체인 A 社 와 S 社 의 최신 모델에 SLP 기판이 일부 채택되었다. '18 년 하반기 이후부터 글로벌 세트업체들의 SLP 채용량이 확대될 것으로 예상된다.

글로벌 세트 업체들의 고민은 스마트폰의 공간 활용도를 최대한으로 확보하는 것이다. 배터리 크기를 확대하여 수명을 늘리거나 고성능 부품을 탑재하기 위함이다. SLP 는 집적도가 높아 스마트폰의 공간을 효율화할 수 있는 차세대 인쇄회로기판이다. 스마트폰 메인 기판 시장이 HDI(High Density Interconnection) 에서 SLP 로 전환될 것으로 전망된다.

SLP 는 12 층의 얇은 기판으로 적층하여 구성된 기존 HDI 기판에 MSAP(Modified Semi Additive Process) 공법을 적용한 것이다. 12 개 층 중 2~4 개 층 회로를 얇게 만들어 기판의 선폭과 간격을 각각 30/30 μm~20/20 μm 수준까지 줄일 수 있게 된 것이다.

SLP 양산 능력을 보유하고 있는 국내 PCB 업체 D 社 에 대해 MSAP 공정용 박리액을 공급 중이다. 고객사 확대를 위해 S 社 內 테스트를 진행 중이다. MSAP 공정용 박리액의 안정적인 공급이 이루어짐에 따라 향후 동도금액과 캐리어 극동박 등 다양한 제품으로 제품군을 확대할 수 있을 것으로 기대된다.

Exhibit 9. 주요 고객사 SLP 기판



Source: 삼성전기, Leading Research Center

Exhibit 10. HDI 와 SLP 비교

구분	제조 공법	구현 가능 선폭/간격
HDI	텐팅	30/40
SLP	텐팅 + MSAP	20/20

Source: Company Data, Leading Research Center

기업개요 – FPCB 用 도금 화학소재 국산화에 앞장서다

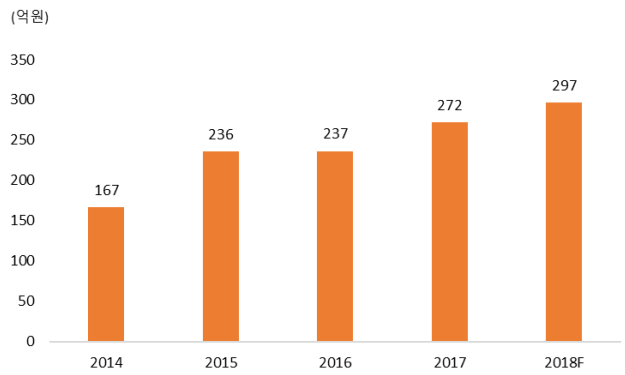
동사는 스마트폰에 탑재되는 PCB, 특히 FPCB/RFPCB 를 생산하는 PCB 업체에 도금 用 화학소재를 공급하는 회사이다. '17 년 기준 동사 매출액에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 사업부는 39.5% 를 차지하는 최종표면처리 부문이었다.

최종표면처리란 PCB 기판의 전기적 흐름을 원활하게 하고 산화와 부식을 방지하기 위해 구리 회선 위에 금도금 처리를 하는 공정이다. FPCB, RFPCB 등 밀도가 높고 연성이 필요한 기판에 금도금 처리를 통해 손상이 발생하지 않도록 하는 것이 동사의 기술력이다.

가격경쟁력과 더불어 엔지니어 수준의 동사 영업 인력들이 고객사에 상주하며 모든 기술서비스를 제공하고 있어 고객사들이 동사 제품을 사용하기를 선호한다. '17 년 기준 M/S 는 70% 수준으로 PCB 도금 用 화학소재 국산화를 이루어내 높은 시장점유율을 유지하고 있는 것으로 추정된다.

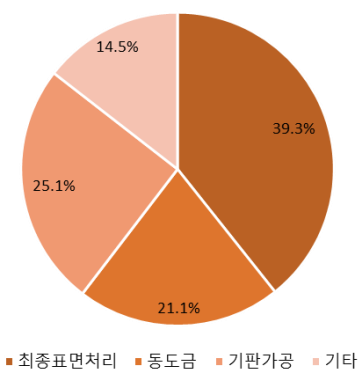
최종표면처리 사업부는 동사의 안정적인 Cash cow 역할을 할 것으로 예상된다. 이를 바탕으로 상기 동도금 소재의 국산화, 기판 외주 가공 확대, MSAP 공정 소재 공급 증대를 통한 지속적인 실적 성장이 기대된다.

Exhibit 11. 최종표면처리 매출액 추이



Source: Company Data, Leading Research Center

Exhibit 12. 매출액 비중(2017)



Source: Company Data, Leading Research Center

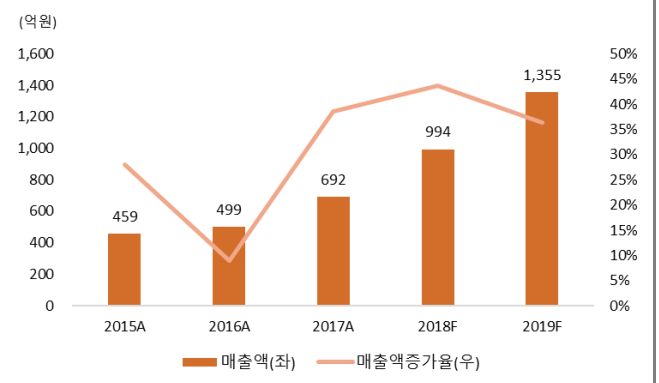
실적전망 및 투자의견

동사의 **'18 년 실적은 매출액 994 억원(YoY+43.7%), 영업이익 307 억원(YoY+91.0%), 당기순이익 237 억원 (YoY+163.4%)을 전망**한다. 실적 성장은 전방 시장 성장에 따른 FPCB 시장 호황으로 동도금 화학소재 공급 증가와 기판 외주 가공 확대에 기인한다.

투자의견 '매수(BUY)' 및 목표주가 47,000 원을 제시하며, 커버리지를 개시한다. 목표주가 47,000 원은 12M Fwd BPS 12,354 원에 Target PBR 3.8 배를 적용하였다. Target Valuation 은 동사의 과거 PBR Band 평균 값이다.

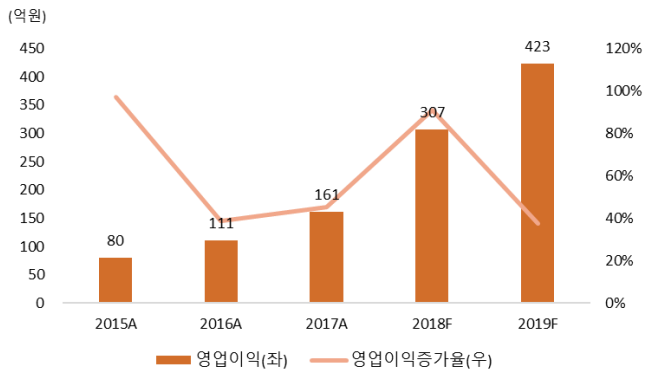
지난해 일본 PCB 업체들이 생산하던 북미 세트 업체 向 RFPCB 물량이 국내로 이전함에 따라 국내 FPCB 시장의 확대가 이루어졌다. 올해 FPCB 시장은 스마트폰에 채택되는 Flexible OLED 디스플레이 확대, 듀얼 카메라 적용 스마트폰 증가 등 요인에 기인하여 호황이 유지될 것으로 분석된다. FPCB 시장 호황으로 동사의 동도금 用 화학소재 공급 및 자회사 YPT 社의 기판가공 매출이 확대될 것으로 전망되어 실적 성장모멘텀을 확보하였다고 판단된다. 이에 동사의 과거 Valuation Band 평균을 적용하였다.

Exhibit 13. 매출액 및 매출액성장률



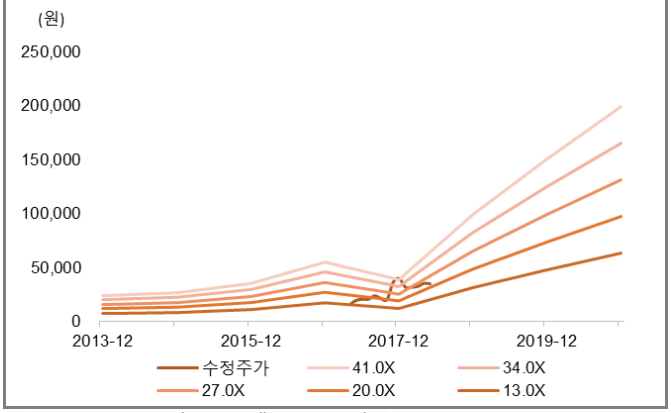
Source: Company data, Leading Research Center

Exhibit 14. 영업이익 및 영업이익성장률



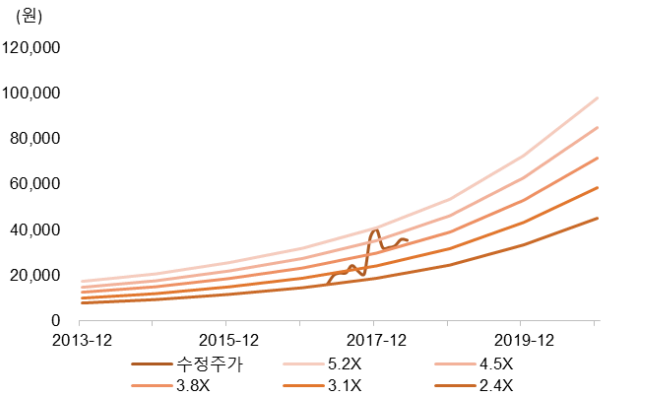
Source: Company data, Leading Research Center

Exhibit 15. PER band



Source: Company data, Leading Research Center

Exhibit 16. PBR band



Source: Company data, Leading Research Center

재무제표

재무상태표

(단위: 억원)	2015A	2016A	2017A	2018F	2019F
자산총계	738	801	1,140	1,457	1,862
유동자산	346	383	571	745	971
현금및현금성자산	78	108	224	292	381
단기금융자산	18	20	17	23	29
매출채권및기타채권	176	182	236	308	402
재고자산	62	66	83	108	141
비유동자산	392	418	569	712	891
장기금융자산	17	21	24	32	42
관계기업등투자자산	0	0	0	0	0
유형자산	300	317	465	607	791
무형자산	26	33	34	45	58
부채총계	462	369	475	566	652
유동부채	310	213	242	316	412
단기차입부채	212	140	145	189	247
기타단기금융부채	14	0	0	0	0
매입채무및기타채무	62	60	79	103	134
비유동부채	151	156	233	250	240
장기차입부채	120	123	202	263	343
기타장기금융부채	13	2	0	0	0
자본총계*	276	432	665	891	1,210
지배주주지분*	229	374	583	808	1,128
비지배주주지분	47	58	82	82	82

(주1) 회계실체가 별도인 경우, * 항목은 자본총계임

포괄손익계산서

(단위: 억원)	2015A	2016A	2017A	2018F	2019F
매출액	459	499	692	994	1,355
매출원가	269	293	415	586	793
매출총이익	190	207	277	408	562
판매비와관리비	110	96	116	100	140
영업이익	80	111	161	307	423
EBITDA	101	135	188	316	434
비영업손익	-17	-8	-40	-5	6
이자수익	0	1	1	2	3
이자비용	16	15	8	7	7
배당수익	0	0	0	0	0
외환손익	3	2	-12	-5	1
관계기업등관련손익	0	0	0	0	0
기타비영업손익	-5	4	-21	5	8
세전계속사업이익	63	103	121	303	428
법인세비용	16	26	30	65	92
연결실체변동관련손익	0	0	0	0	0
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익*	47	77	90	237	336
지배주주순이익*	40	65	68	226	320
비지배주주순이익	7	13	22	12	16
기타포괄손익	7	-1	-11	0	0
총포괄손익	54	76	79	237	336

(주1) 회계실체가 별도인 경우, * 항목은 당기순이익임

현금흐름표

(단위: 억원)	2015A	2016A	2017A	2018F	2019F
영업활동으로인한현금흐름	38	99	82	157	198
당기순이익	47	77	90	237	336
현금유입(유출)이없는수	86	78	116	84	106
자산상각비	21	24	27	8	11
영업자산부채변동	-71	-20	-96	-94	-148
매출채권및기타채권	-60	98	-191	-72	-94
재고자산감소(증가)	-6	-108	-24	-25	-33
매입채무및기타채무	-1	-14	137	24	31
투자활동현금흐름	-27	-54	-168	-178	-232
투자활동현금유입액	121	16	24	17	22
유형자산	90	0	5	14	18
무형자산	1	0	0	1	1
투자활동현금유출액	148	70	191	195	254
유형자산	107	39	168	163	212
무형자산	16	6	4	12	16
재무활동현금흐름	-11	-14	211	94	121
재무활동현금유입액	110	91	327	121	158
단기차입부채	35	42	66	51	66
장기차입부채	75	38	144	70	92
재무활동현금유출액	121	105	117	27	37
단기차입부채	54	79	115	7	9
장기차입부채	65	13	2	9	12
기타현금흐름	0	0	0	-5	1
연결범위변동효과	0	0	0	0	0
환율변동효과	1	-1	-9	0	0
현금변동	-0	31	116	68	89
기초현금	78	78	108	224	292
기말현금	78	108	224	292	381

투자지표

(단위: 원,배,%)	2015A	2016A	2017A	2018F	2019F
주당지표 및 주가배수					
EPS*	886	1,338	958	3,048	4,316
BPS*	5,006	7,748	8,216	10,915	15,232
CFPS	821	2,060	1,150	2,121	2,678
SPS	10,033	10,351	9,758	13,423	18,298
EBITDAPS	2,199	2,797	2,651	4,262	5,858
DPS (보통,현금)	0	0	0	0	0
배당수익률 (보통,현금)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당성향 (보통,현금)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PER*	0.0	0.0	43.9	11.6	8.2
PBR*	0.0	0.0	5.1	3.2	2.3
PCFR	0.0	0.0	36.5	16.7	13.2
PSR	0.0	0.0	4.3	2.6	1.9
EV/EBITDA	2.0	0.7	16.0	8.5	6.3
재무비율					
매출액증가율	28.0	8.9	38.6	43.7	36.3
영업이익증가율	97.3	38.9	45.1	91.0	37.6
지배주주순이익증가율*	61.3	63.0	16.4	163.4	41.6
매출총이익률	41.4	41.4	40.0	41.0	41.5
영업이익률	17.4	22.2	23.2	30.9	31.2
EBITDA이익률	21.9	27.0	27.2	31.8	32.0
지배주주순이익률*	10.4	15.5	13.0	23.9	24.8
ROA	11.3	14.4	16.6	23.7	25.5
ROE	19.7	21.4	14.2	32.5	33.0
ROIC	12.8	16.1	19.0	28.7	30.2
부채비율	167.6	85.4	71.4	63.6	53.8
차입금비율	120.3	60.8	52.1	50.8	48.7
순차입금비율	89.6	34.9	17.7	17.2	16.6

(주1) 회계실체가 별도인 경우, * 항목은 당기순이익 및 자본총계 기준임

Source: Company Data, Leading Research Center

▶ Compliance Notice

본 자료를 작성한 금융투자분석사는 동 자료를 작성함에 있어서 기재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

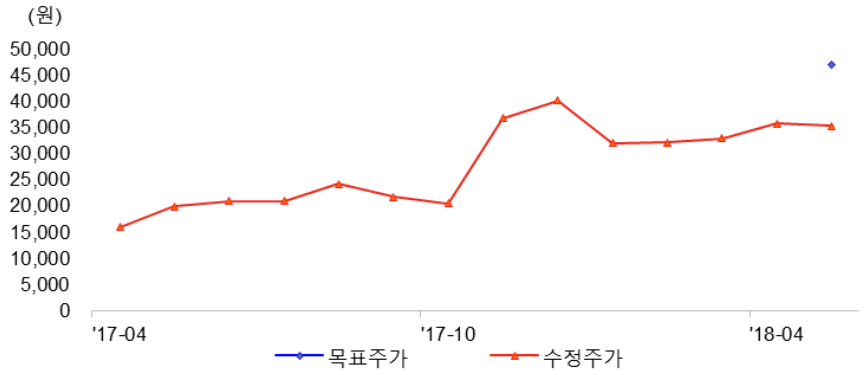
- *당사는 보고서 작성일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.*
- *본 보고서를 작성한 금융투자분석사는 작성일 현재 해당회사의 유가증권을 보유하고 있지 않습니다.*
- *당사는 보고서 작성일 기준 해당회사와 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다.*
- *본 자료는 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전에 제공된 사실이 없습니다.*
- *당사는 지난 6 개월간 해당회사의 유가증권의 발행업무를 수행한 사실이 없습니다.*
- *본 자료는 고객의 투자에 정보제공 목적으로 작성되었으며, 작성된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 기반으로 한 것이나 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 그러므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바라며, 어떠한 경우에도 본 자료는 투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.*
- *본 자료의 모든 저작권은 당사에 있으며, 무단복제, 변형 및 배포될 수 없습니다.*

▶ 최근 2 년간 투자등급 및 목표주가 변경 내용

와이엠티(251370)	
일자	2018-5-14
투자의견	BUY(신규)
목표주가	47,000 원
괴리율(%)	
평균주가대비	-
최고(최저)주가대비	-

** 괴리율 산정: 목표주가 대상시점은 1 년이며 수정주가를 적용*

▶ 최근 2 년간 목표주가 변경 추이



▶ 투자기간 및 투자등급

기업

BUY (매수)	향후 12개월간 현재 주가 대비 절대 수익률 15% 이상
HOLD (중립)	향후 12개월간 현재 주가 대비 절대 수익률 ± 15% 내외
SELL (매도)	향후 12개월간 현재 주가 대비 절대 수익률 -15% 이하

산업

OVERWEIGHT (비중확대)	향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 상회 예상
NEUTRAL (중립)	향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 ± 5% 예상
UNDERWEIGHT (비중축소)	향후 12 개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 하락 예상

▶ 조사분석자료 투자등급 비율 (기준일 : 2018.3.31)

BUY (매수)	100.0%
HOLD (보유/중립)	0.0%
SELL (매도)	0.0%
합계	100.0%

*©. 2018 **Leading Investment & Securities Co**. All rights reserved*